

ウェットエッチング用酸・アルカリ耐性フッ素樹脂ウェーハキャリア

6インチPtfeウェーハ洗浄ラック

商品番号: PL-CP421



前書き

過酷なウェットエッチングプロセス向けに設計された高純度6インチPTFEウェーハ洗浄ラック。これらの耐酸性フッ素樹脂キャリアは、半導体製造および要求の厳しい実験室の超微量分析アプリケーションや化学処理において、卓越した化学的安定性と超低汚染を提供します。

詳細を学ぶ

アプリケーション	説明	主なメリット
半導体ウェットエッチング	HF、BOE、または高温リン酸浴中でのシリコンウェーハの処理。	金属汚染を防ぎ、過酷な化学薬品に耐えます。
太陽電池製造	太陽電池製造のためのシリコン基板の洗浄およびテクスチャリング。	高耐久性と腐食性テクスチャリング溶液への耐性。
超微量金属分析	ICP-MS分析前の実験室用ガラス器具および基板の洗浄。	超低バックグラウンドレベルとイオン溶出ゼロによる正確なデータ。
MEMS製造	深リアクティブイオンエッチングまたはウェットリリース中のマイクロ電気機械システムの取り扱い。	脆い構造物に対する高寸法精度による繊細な取り扱い。
化学気相堆積 (CVD)	高品質な薄膜成長を確保するための基板のプレクリーン。	前処理酸に耐えることで、原子レベルの清浄な表面を確保します。
医薬品洗浄	医薬品研究開発における高純度コンポーネントの滅菌および洗浄。	滅菌剤に対する優れた耐性を持つFDA準拠材料。
めっきプロセス	酸またはアルカリ浴中での精密金属堆積中の基板の保持。	電気絶縁性およびめっき電解液への完全な耐性。

仕様カテゴリ	PL-CP421の詳細
型番	PL-CP421
ベース材料	高純度バージンPTFE（ご要望によりPFA/TFMも可能）
主なウェーハ径	6インチ（150mm）標準
ウェーハ収容能力	完全カスタマイズ可能（例：25スロット、50スロット、または特注枚数）
スロット幅/ピッチ	基板の厚さおよび間隔要件に合わせてカスタマイズ可能
ハンドル設計	固定式、取り外し式、または延長式（浴の深さに合わせてカスタマイズ）
耐熱温度	-200°C～+260°C (-328°F～+500°F)
製造方法	5軸精密CNC加工
表面仕上げ	Ra < 0.8μm（標準）またはカスタマイズされた研磨

仕様カテゴリ	PL-CP421の詳細
耐薬品性	普遍的（溶融アルカリ金属とフッ素元素を除く）
コンプライアンス	半導体グレード / 超微量分析グレード